## 电子软钎焊连接技术 材料性能及可靠性



作者: (美) 杜经宁作; 赵修臣, 霍永隽, 宁先进译

出版社:北京:北京理工大学出版社

出版日期: 2021.05

总页数: 257

介绍:本书主要介绍了软钎焊中铜与锡之间的反应问题以及外部应力对焊料接头可靠性的影响。全文共分为三部分:第一部分导论(第1章)为倒装芯片焊接技术概述,主要介绍了倒装芯片技术的重要性及目前存在的问题,还阐述了电子封装技术的未来趋势及焊料连接技术在电子封装技术中的重要作用;第二部分(第2章-第7章)为金属铜与金属锡的反应问题,主要介绍了块状及薄膜状样品中互连界面处铜锡间的反应问题;第三部分(第8章-第12章)为外部应力对焊料接头的可靠性的影响,主要介绍了焊料接头中的电迁移和热迁移现象、基本原理及对互连接头造成的应力影响等等。本书可为电子制造行业里从事焊料连接技术的工程师和科学家提供一个参考,同时本书也可作为高年级本科生及研究生学习电子封装技术可靠性理论的参考教材。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/96280317.html) 查找全本阅读方式

电子软钎焊连接技术 材料性能及可靠性 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/96280317.html

教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/96280317.html

书名: 电子软钎焊连接技术 材料性能及可靠性